

2016年6月21日

ニュースリリース

図研グループのジーサスが、「モノづくりトータルコスト 50%低減セミナー」を開催
モノづくり先進企業の経営層やエキスパートが登壇

株式会社図研のグループ会社である株式会社ジーサス(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:野田健彦、以下ジーサス)は、電気・電子機器のハードウェア設計に関わる管理職、エンジニアを対象に、「モノづくりトータルコスト 50%低減セミナー」を開催いたします。本セミナーでは、株式会社リコー、シンフォニアテクノロジー株式会社、オムロン株式会社、株式会社日立製作所(講演順)より、モノづくりの第一線で活躍中の経営層やエキスパートにご登壇いただき、その先進的な取り組み事例をご紹介します。

製品設計部門を取り巻く環境は、大きく変化しつつあります。IoTの普及により、様々な製品にセンサーや無線通信などが機能要件に加わり、筐体は小型・軽量化するなど、設計は複雑さを増しています。これらの高度な要求を叶えつつ収益を生む新製品開発を行うには、コスト削減は最重要課題です。従来コスト削減は主に製造や購買部門で進められてきましたが、製品コストの80%は設計段階で決まるとも言われコスト削減を効果的に行うためには設計段階での取り組みがますます重要となっています。

ジーサスは、創業以来数多くのお客様の設計現場で設計プロセスの効率化とコストダウンに取り組んで参りました。今回のセミナーでは、そうした実績の中から、モノづくり企業の多くの方々にヒントとなる実践的な取り組み事例や、設計ノウハウをご紹介します。セミナー終了後は、講演者と参加者の皆様が情報交換できる懇親会を予定しております。

皆様のご参加を、心よりお待ちしております。

【セミナー概要】

日時: 2016年07月22日(金) 13:30-17:30(13:00 受付開始)

会場: 新横浜国際ホテル 2F クリスティ (神奈川県横浜市港北区新横浜 3-18-1)

地図: <http://sinyokohama.khgrp.co.jp/info/access.html>

受講料: 無料

定員: 100名(応募数多数の場合は抽選とさせていただきます)



【プログラム】

- 13:30 - 13:40 ご挨拶
- 13:40 - 14:20 IoTを活用したリコーのモノ+コトづくり
株式会社リコー 理事 IJ 事業部副事業部長 兼 リコーIT ソリューションズ株式会社
取締役 森田 哲也様
- 14:20 - 15:00 設計開発プロセスの効率化を目指した熱設計教育の取り組み
シンフォニアテクノロジー株式会社 開発本部 研究部 担当課長 稲葉 純吉様
- 15:00 - 15:20 Coffee Break
- 15:20 - 15:50 ジーサスモノづくり支援サービスのご案内
株式会社ジーサス 技術統括部長 藤田 哲也
- 15:50 - 16:30 オムロンにおける熱設計フロントローディングの取り組み
オムロン株式会社 グローバルものづくり革新本部 開発プロセス革新センタ
開発フロントローディング部 主査 下山 英司様
- 16:30 - 17:10 設計の一工夫が原価を下げる
株式会社日立製作所 ICT 事業統括本部 ITプロダクツ統括本部 エンジニアリング
第2本部 本部長 船田 孝様
- 17:30 懇親会

■ 申込み方法

お申込みはこちら <http://www.zsas.co.jp/info/seminar/2016pvsemi.php>

■ ジーサスについて <http://www.zsas.co.jp/>

ジーサスは、「スキル・ツール・プロセス」の観点からお客様の設計開発に関わる技術コンサルティング、オンサイト設計支援サービスを提供しています。2012年に熱設計支援システム「ThermoSherpa」をリリース、2015年にはノイズ対策、2016年には消費電力解析のソリューションを含めた電気・電子機器の設計支援サービスを提供しています。

【この件に関するお問合せ先】

株式会社図研 コーポレートマーケティング室

TEL:045-942-1511(代)

お問合せメールアドレス:koho@zuken.co.jp